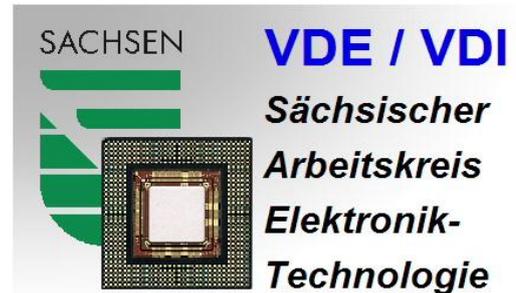


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  
01069 Dresden  
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann, TU Dresden  
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



### **60. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**

Am **Mittwoch, den 21. März 2012**  
zum Thema: **Aktuelle Trends in der Montagetechnik**  
im Headquarter von **ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG** in München

ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
Rupert-Mayer-Strasse 44  
81379 München  
<http://www.siplace.com>

#### Programm:

- ab 10:30 Empfang, offene Diskussionsrunde zum Erfahrungsaustausch
- 11:00 Begrüßung und Vorstellung der ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG.  
**Herr Rentzsch, Herr Schindler COO**
- 11:30 Vortrag: Innovatives Löten mit Nanotechnologie  
**Dipl.-Ing. Norbert Heilmann**, ASM Assembly Systems
- 12:00 Vortrag: Aufbau einer "lean production" für die Fertigung von SMD-Bestückungsautomaten  
Abteilung SCM , ASM Assembly Systems  
**Herr Cwojdzinski**
- 12:30 **Mittagsbuffet**
- ab 13:15 Gruppe 1 / Gruppe 2  
Werksführung: Fertigung von SIPLACE-Bestückautomaten, eigene moderne  
Elektronikfertigung, Applikationscenter (im Applikationscenter Bestückung eines Demoboard  
mit einer SIPLACE) **Herr Bonara / Herr Patzner / Herr Oeckl**
- 13:15 Gruppe 1 : SIPLACE-Maschinen .....Elektronikfertigung.....(ab 14:15 Uhr) Applikationscenter  
13:15 Gruppe 2 : Elektronikfertigung... (ab 13:45 Uhr)Applikationscenter.....SIPLACE-Maschinen
- 14:45 **Kaffeepause**
- 15:00 Vortrag: Neueste Leiterplattentechnologie, Jenaer Leiterplatten, **Herr Jens Ohlwein**
- 15:30 Vortrag: Neueste Entwicklungen im Schablonendruck  
**Dipl.-Ing. Lothar Pietrzak**, Dipl.-Ing. Daniel Rudolph, Christian Koenen GmbH
- 16:00 Praktische Vorführung: Löten mit Nanotechnologie am Beispiel von temperatursensiblen LED-  
Bauelementen  
**Dipl.-Ing. Norbert Heilmann, ASM**

gegen 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung